



第70回 半導体・集積回路技術シンポジウム

2006年7月6日(木)・7日(金)

機械振興会館ホール

第1日

7月6日(木) 10:15~17:00

<10:15> 開会の挨拶 電子材料委員会委員長
<10:20~11:10>
1. 招待講演 CMOS デバイスのための HfSiON ゲート絶縁膜実用化の現状と課題

東芝:

小山正人、小池正浩、井野恒洋、上牟田雄一、飯島良介、西山彰

<11:10~12:00>

2. 招待講演 Conductive-AFM によるゲート絶縁膜劣化現象のナノスケール評価

¹名大、²豊田中研:

財満顕明¹、世古明義¹、渡辺行彦²、坂下満男²、酒井朗¹、小川正毅¹

<12:00~12:25>

3. 45nm high-k CMIS プラットフォームにおける Vth 制御とばらつき抑制

ルネサステクノロジ:

林岳、水谷斉治、井上真雄、由上二郎、土本淳一、安間正俊、小森重樹、塚本和宏、塚本康正、新居浩二、西田征男、佐山弘和、山下朋弘、尾田秀一、柴森貴尚、大路謙

<12:25~13:30>

昼食

<13:30~14:20>

4. 招待講演 つくば半導体コンソーシアム

半導体先端テクノロジーズ: 渡辺久恒

<14:20~14:45>

5. 分割 CVD 法を用いて形成した PMIS 向け TiN メタルゲート電極

ルネサステクノロジ:

坂下真介、川原孝昭、水谷斉治、井上真雄、山成真一、西田征男、森健壹、村田直文、本田和仁、土本淳一、由上二郎、藤原啓司

<14:45~15:10>

6. 窒化ハフニウムゲートの仕事関数制御

富士通研究所:

倉橋輝雄、坂本学、崎田幸恵、三島康由

<15:10~15:20>

休憩

<15:20~16:10>

7. 招待講演 プラズマドーピング

¹ユージェーティージャポ、²東工大:

水野文二¹、佐々木雄一朗¹、金成国¹、岡下克巳¹、伊藤裕之¹

筒井一生²、岩井洋²

<16:10~16:35>

8. エピSi S/D構造によるローカル歪みとSi/SiGe構造によるグローバル歪みと<100>チャネル方向を組み合わせた高性能CMOSFET

¹東芝セミコンダクター、²ソニー:

佐貫朋也¹、田中秀¹、太田和伸²、藤井修¹、山口理恵¹、中山和宏¹、森政幸夫¹、高須靖夫¹、井出淵純¹、西山伸泰¹、福井大伸¹、吉村尚郎¹、松尾浩司¹、水島一郎¹、伊藤仁¹、竹川陽一¹、斎藤正樹²、岩井正明¹、長島直樹²、松岡史倫¹

<16:35~17:00>

9. TCAD シミュレーションを用いたナノスケール CMOS デバイスの解析

富士通研究所: 田辺亮、芦澤芳夫、岡秀樹

<17:15~18:45> -懇親会- アワード贈呈式

第2日

7月7日(金) 10:20~17:00

<10:20~11:10>
10. 招待講演 半導体と MEMS の融合

東京大学: 奥村勝弥

<11:10~11:35>

11. Cu-CMP 用有機砥粒の開発

三井化学:

中村節子、進藤清孝、藤井重治、江藤彰紀、石塚友和

<11:35~12:25>

12. 招待講演 Cu/porous Low-k配線構造の実現に向けたCMP技術開発

東芝セミコンダクター:

西岡岳、矢野博之

<12:25~13:30>

昼食

<13:30~14:20>

13. 招待講演 ユビキタス対応の最先端LSI配線モジュール技術

NEC: 林喜宏

<14:20~14:45>

14. ポーラス low-k 膜の機械物性改善とその評価方法

JSR:

小久保輝一、関口学、高橋要子

<14:45~15:10>

15. p-PAF/p-MSX ハイブリット構造におけるポストキュア技術

- EB と UV の比較

東芝セミコンダクター:

島田美代子、藤田敬次、中尾慎一、坂中敏展、宮島秀史

<15:10~15:20>

休憩

<15:20~16:10>

16. 招待講演 Cu 合金配線を用いた 45nm 世代のバリア層自己形成プロセス

東北大学: 小池淳一

<16:10~17:00>

17. 招待講演 Cu/Low-k配線のストレスマイグレーション

¹富士通研究所、²富士通:

中村友二¹、鈴木貴志¹、河野隆宏²、土川春穂¹

<17:00> 閉会の挨拶

参加申込締切(予約) 6月30日(金)迄に申込書式に従い費用を添えて(現金書留または銀行振込)必ず銀行大岡山支店

普通預金口座 1926159 電子材料委員会小田俊理(オダシユリ)宛にお申込み下さい。銀行振込の際も氏名、勤務先、連絡先をご連絡下さい。

参加登録費 予約 会員 20,000円 会員外 22,000円 大学関係 5,000円 学生 2,500円 (1日のみ 会員 14,000円 会員外 15,000円)

当日 会員 22,000円 会員外 24,000円 大学関係 6,000円 学生 3,000円 (1日のみ 会員 15,000円 会員外 16,000円)

講演論文集のみ希望の場合、郵6,000円でお分け致します。

参加申込、論文集申込先 〒102-0074東京都千代田区九段南4-8-30アルス市ヶ谷202

電気化学会電子材料委員会 (TEL: 03-3234-4213, FAX: 03-3234-3599)

電気化学会電子材料委員会 主催

応用物理学会、高分子学会、精密工学会、電気学会、電子情報通信学会、日本印刷学会、日本化学会、日本金属学会、日本セラミックス協会、日本写真学会、日本表面科学会、日本真空協会、ILK/IC実装学会 協賛